

性能特点

- 本系列灌封胶适用于各种灌封模式
- 100%固态，固化后无渗出物
- 卓越的耐高低温性，极好的耐气候性，耐辐射及卓越的介电性能
- 化学性能和机械性能稳定

产品描述

PAKCOOL® TPC-211 是具有较高导热性能的 1:1 双组分液态电子灌封材料，可在室温或加温下固化。除高导热的特性外，本产品还具有热膨胀率低和绝缘性高等特点，从而更加有效地消除电子元件因工作温度变化产生的破坏作用。本系列产品亦广泛地用于粘合发热的电子器件和散热片或金属外壳。在固化前本产品有优良的流动性和流平性。固化后也不会因为冷热交替使用而从保护外壳中脱出。其灌封表面光滑并无挥发物生成。

典型应用

- LED 组装
- 逆变器
- 高频变压器
- 电源模块
- 汽车电池包
- 通讯设备
- 电子部件

注意事项

- 本产品接触有些物质可能会不固化或不完全固化，这些物质包括：硫、磷、氮的化合物如聚砷、聚硫醚、聚氨酯、含酰胺、胺的物质，含锡、砷、锑、硒、碲成分的物质及一些不饱和的碳氢化合物及增塑剂等
- 因为 A/B 组分的粘度略有差异，如采用机器灌封，需对 B 组分的压力略做调整
- 存放过程中，产品会有填料沉降，属于正常现象，使用前需要将 A、B 组分在各自的桶内刮底刮壁充分搅拌均匀后，再以 1:1 进行混合，并充分搅拌至颜色均匀

技术参数

特性	TPC-211	测试方法
基材	双组分 RTV	--
颜色	A:白色 B:灰色	Visual
A/B 混合比例	1:1	--
粘度 (cP)	≤4000	ASTM D2196-15
操作时间 (min @ 25°C)	>30	--
导热系数 (W/m·K)	1.0	ASTM D5470
硬度 (Shore A)	35±5	ASTM D2240
密度 (g/cm³)	1.65±0.10	ASTM D792
介电强度 (kV/mm)	≥20	ASTM D149
阻燃	V-0	UL 94
保质期 (@室温)	12 个月	--
连续使用温度 (°C)	-50 至 +150	--

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

储存条件

- PAKCOOL® TPC-211 需阴凉干燥处储藏

包装规格

- 500g/罐、15Kg/桶和 30Kg/桶的包装规格，并可根据客户需求定制

固化时间

- TPC-211 硅胶在室温下放置 8 至 24 小时即可自然固化。其交联时间将随温度升高而缩短（参见下表）。

25°C	24 小时
70°C	40 分钟

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。